

## 半導体事業譲渡に伴うお知らせ

パナソニック株式会社の半導体事業は、2020年9月1日にNuvoton Technology Corporation（以下、Nuvoton）へ譲渡され、パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社は、ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社（以下、NTCJ）としてNuvotonグループの会社となりました。

これに伴い、2020年9月1日以降、半導体商品はNTCJ製となりますが、引き続き、パナソニック株式会社を通じた販売を継続いたします。

本ドキュメントにつきましては、製造元であるNTCJが発行しています。本文中にパナソニック/パナソニック セミコンダクターソリューションズの記述がございましたら、NTCJに読み替えてご使用ください。

※ “本書に記載の技術情報および半導体のご使用にあたってのお願いと注意事項”を除く

ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社

### Description

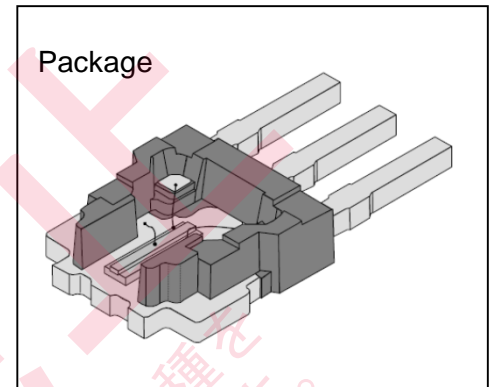
LNCT22PK01WW is a MOCVD fabricated 660 nm and 780 nm band dual wavelength laser diode with multi quantum well structure, adapting open type frame package to reduce the size and weight.

### Feature

- Dual wavelength: 661 nm (typ) and 785 nm (typ)
- High output power: 280 mW (pulse) for Red and 380 mW (pulse) for IR
- Package : Flat package
- Operating temperature : Max. +85°C

### Application

- Optical disk drive
- Sensing
- Industrial use



### Absolute Maximum Ratings <sup>3)</sup>

LD	Item	Symbol	Value	Unit	Condition
RED	Output power	Po	100	mW	CW
			280	mW	pulse <sup>1)</sup>
	Reverse voltage	Vr	1.5	V	CW
	Operating case temperature	Tc	-10 to +85	°C	CW/pulse
IR	Output power	Po	200	mW	CW
			380	mW	pulse <sup>2)</sup>
	Reverse voltage	Vr	1.5	V	CW
	Operating case temperature	Tc	-10 to +85	°C	CW/pulse
	Storage temperature	Tstg	-40 to +85	°C	

- Note) 1) Pulse width  $\leq 30$  ns, duty  $\leq 33\%$  for RED-LD  
 2) Pulse width  $\leq 100$  ns, duty  $\leq 50\%$  for IR-LD  
 3) These ratings are guaranteed only when RED-LD or IR-LD is turned on individually.

### Electrical and Optical Characteristics

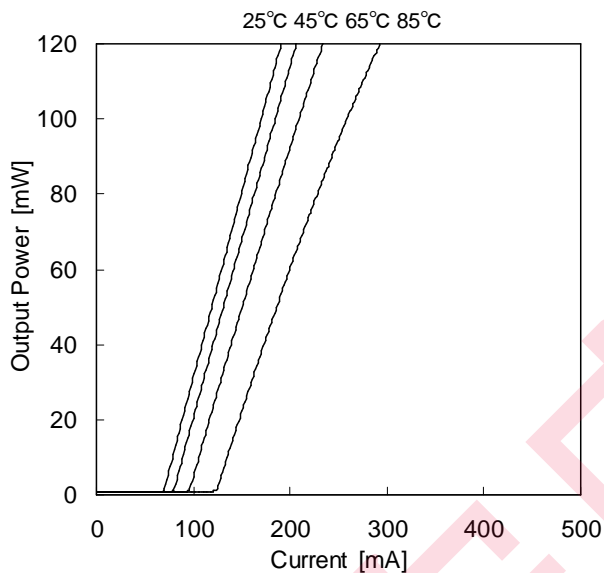
Tc =25°C, CW, Po=100mW for RED-LD, 200mW for IR-LD

LD	Item	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
RED	Threshold current	Ith	-	65	95	mA	
	Operating current	Iop	-	160	230	mA	
	Operating voltage	Vop	-	2.3	3.0	V	
	Wavelength	$\lambda$	656	661	665	nm	
	Beam divergence	Parallel	$\theta_h$	7.5	9.0	13.0	deg
Perpendicular		$\theta_v$	13.0	16.0	19.5	deg	FWHM
IR	Threshold current	Ith	-	60	95	mA	
	Operating current	Iop	-	260	380	mA	
	Operating voltage	Vop	-	2.4	3.2	V	
	Wavelength	$\lambda$	777	785	791	nm	
	Beam divergence	Parallel	$\theta_h$	6.0	7.5	11.5	deg
Perpendicular		$\theta_v$	12.0	15.0	19.0	deg	FWHM

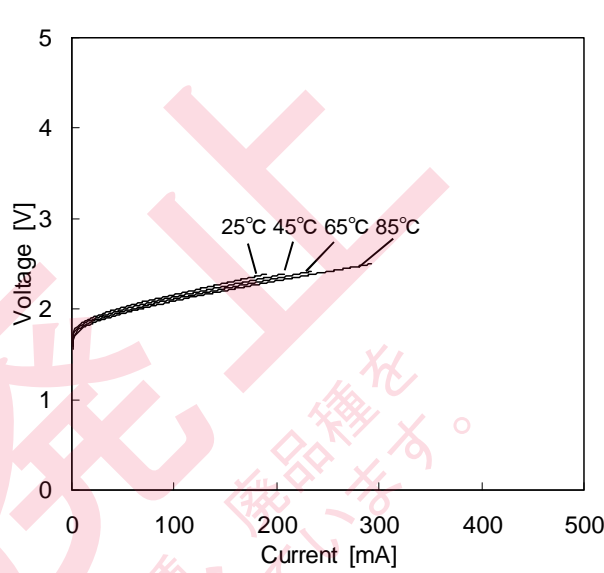
FWHM : Full width at half maximum

### Representative Characteristics [RED-LD]

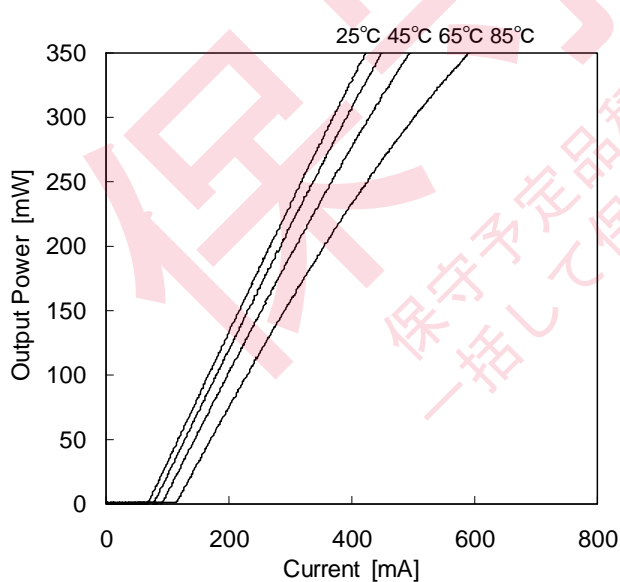
Output Power vs Current (CW)



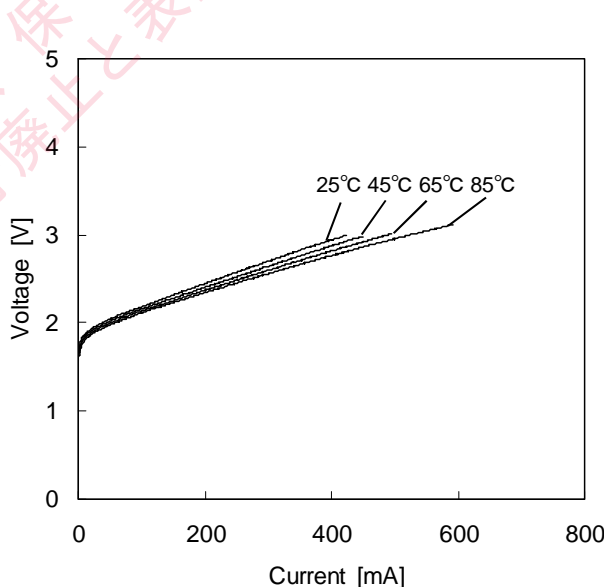
Voltage vs Current (CW)



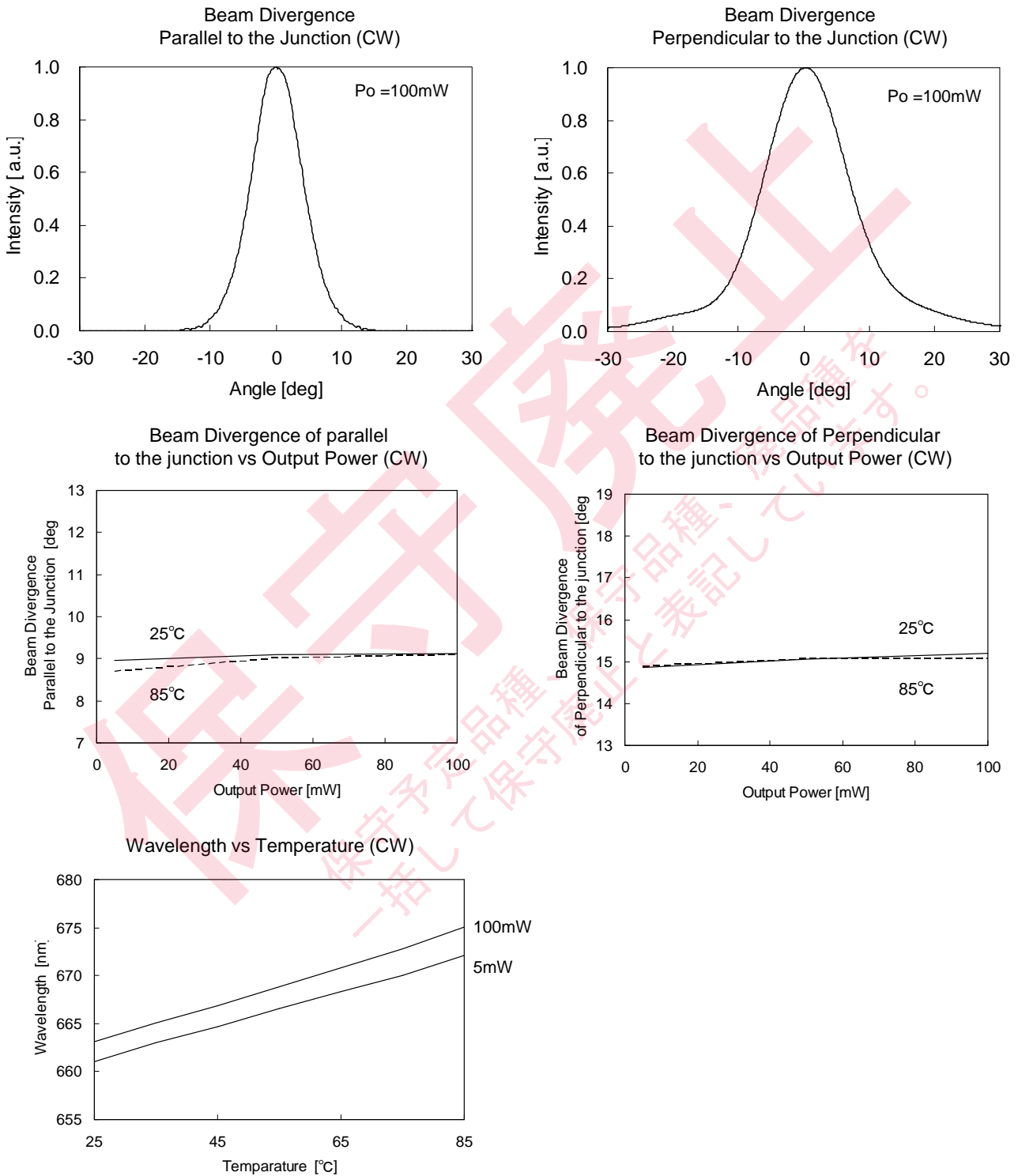
Output Power vs Current (Pulse)



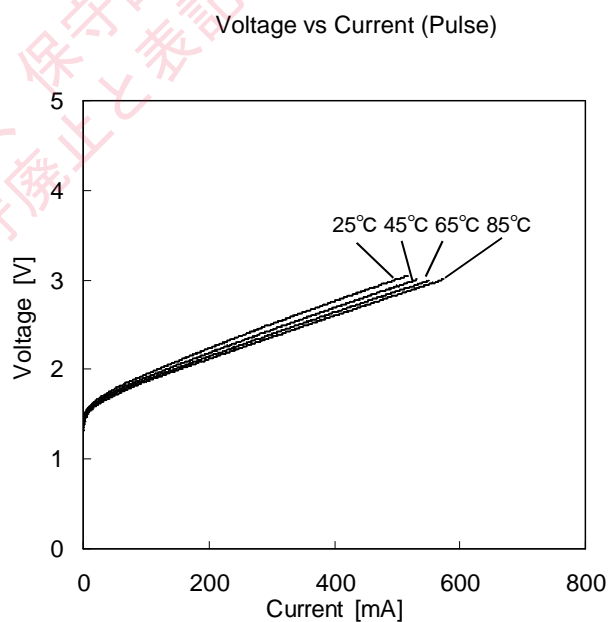
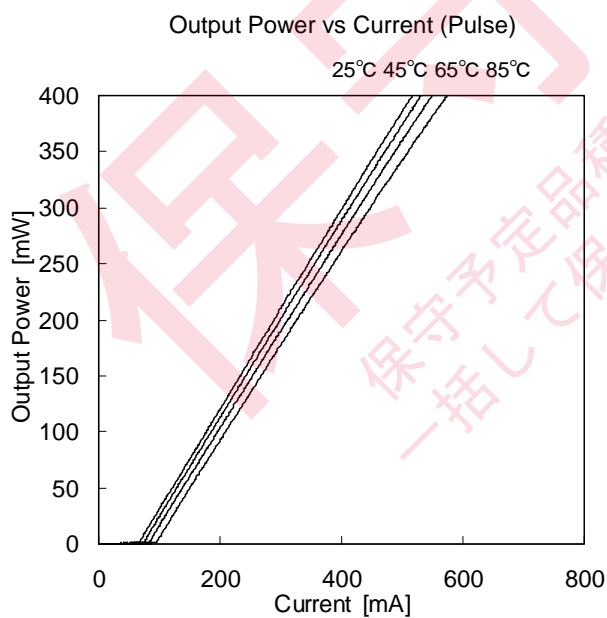
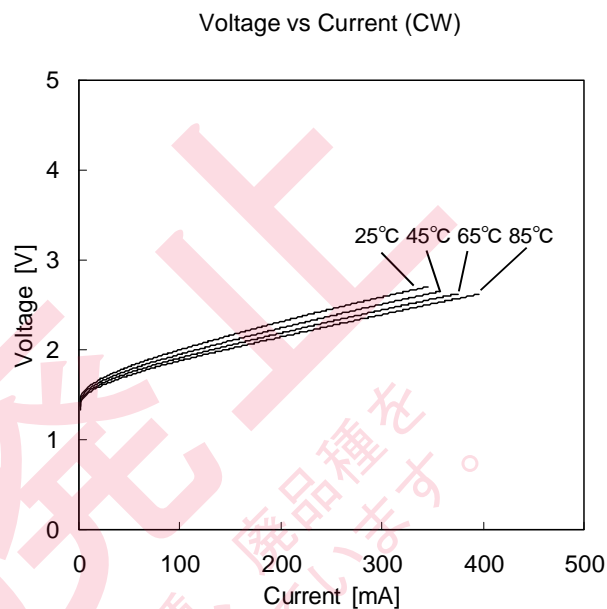
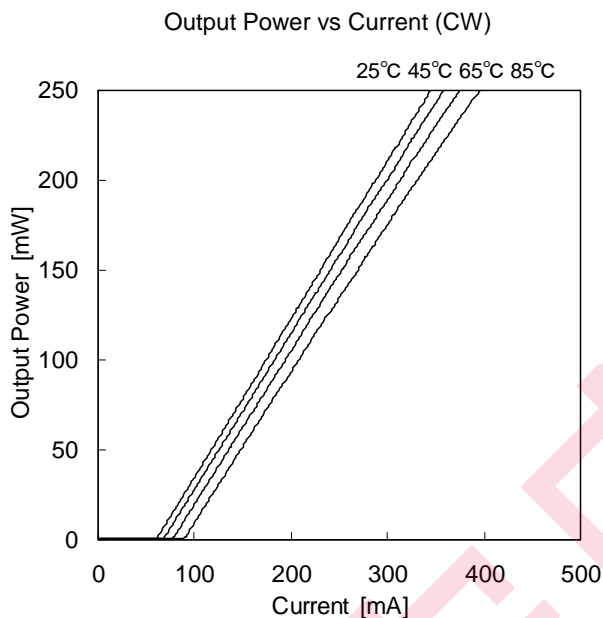
Voltage vs Current (Pulse)



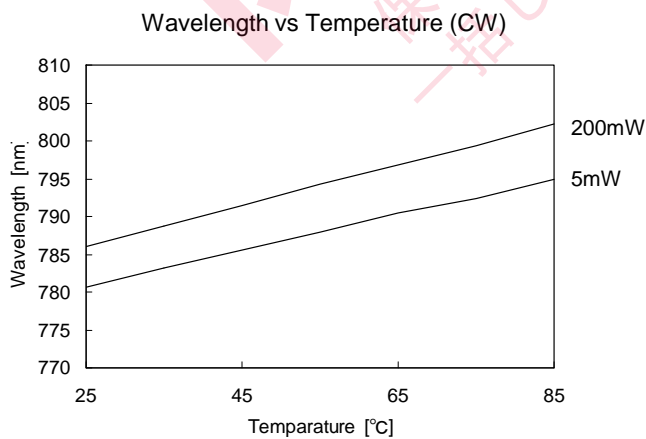
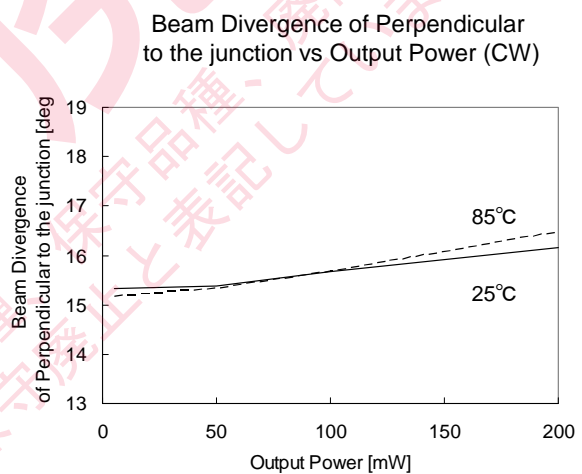
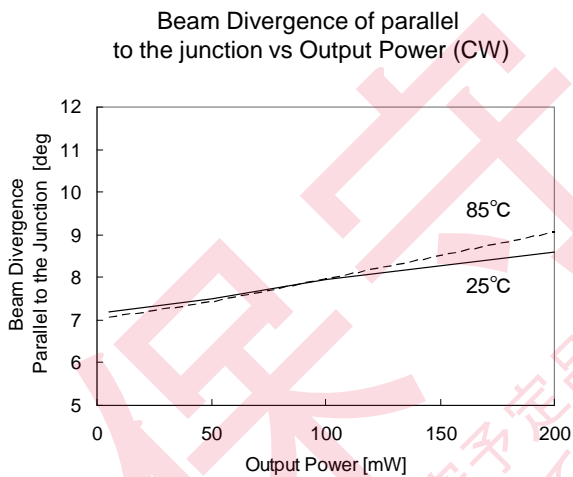
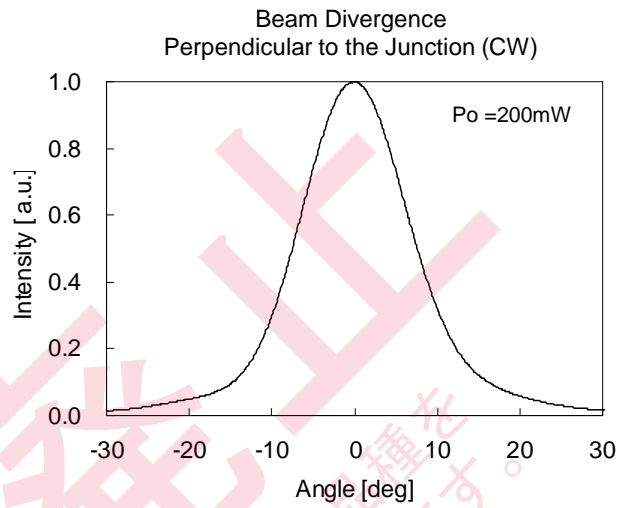
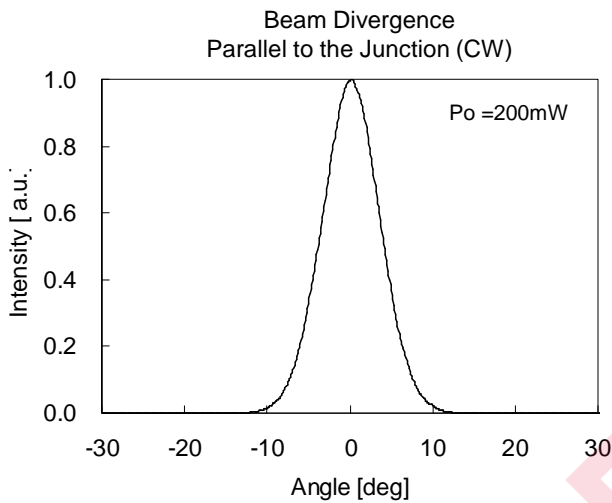
Representative Characteristics [RED-LD]



### Representative Characteristics [IR-LD]

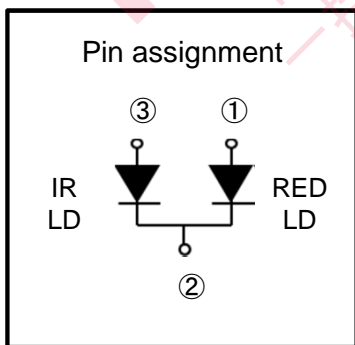
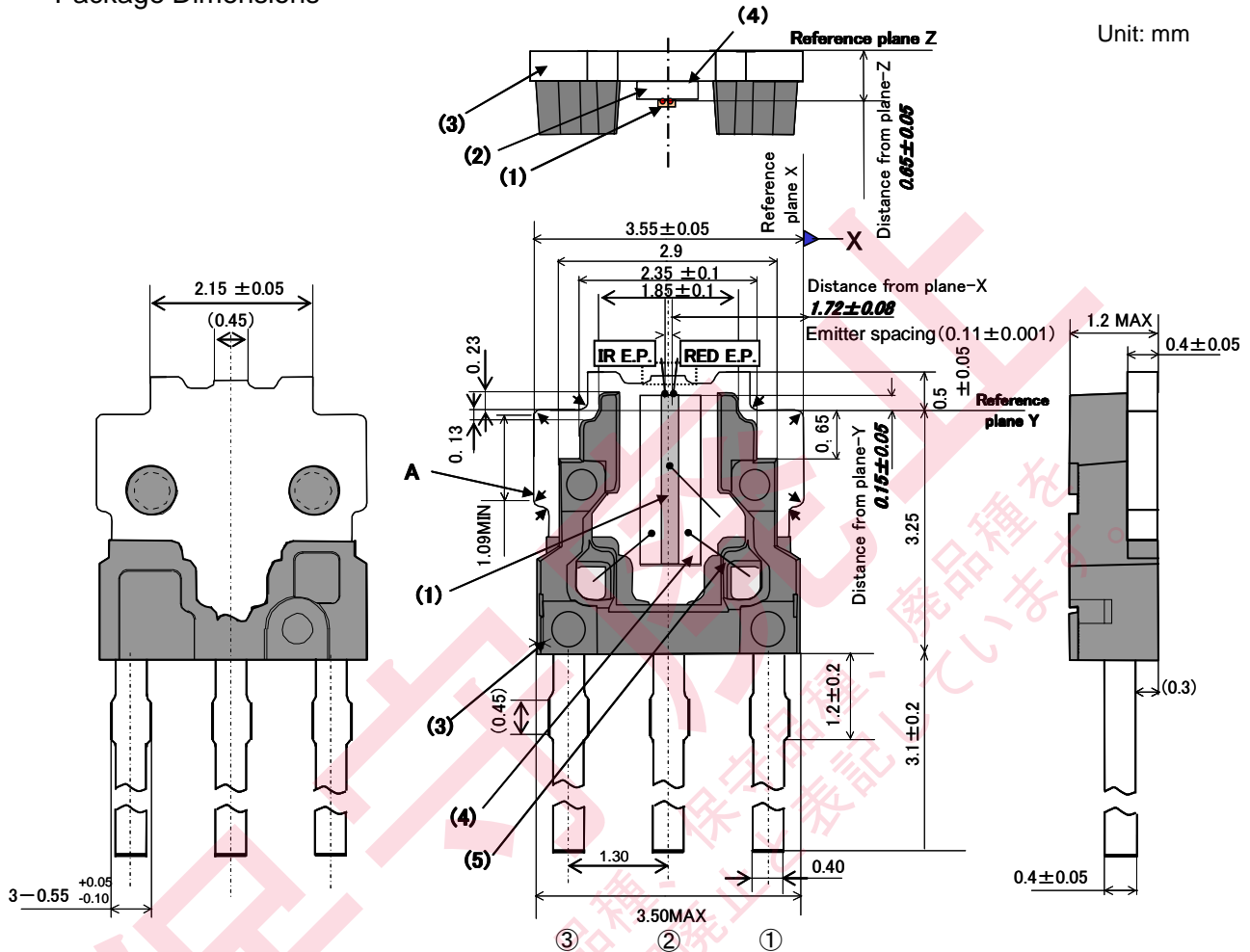


Representative Characteristics [IR-LD]



Package Dimensions

Unit: mm



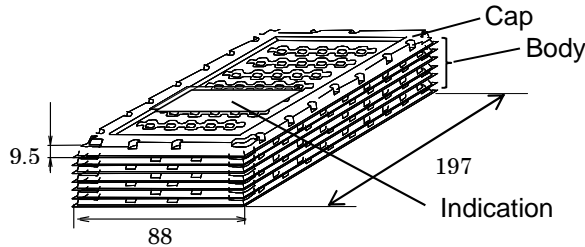
- (1) LD Chip
  - (2) Submount
  - (3) Package
  - (4) Ag Paste
  - (5) Au Wire
- E.P. = Emitting point
  - General corner R is 0.25mm

### Packing Specifications

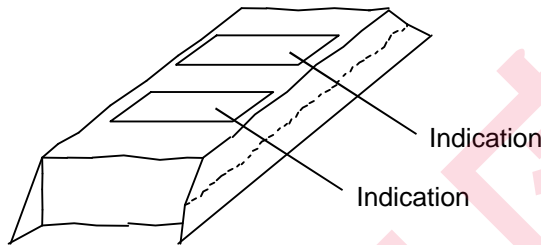
#### 1 Packing Material

##### 1.1 Tray

Material: Conductive Polystyrene

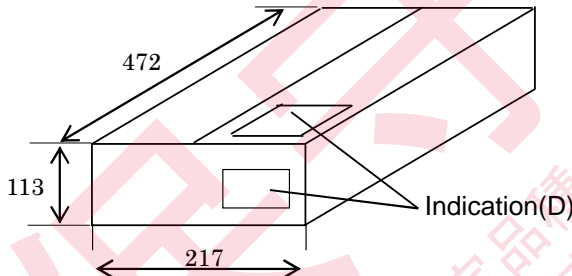


##### 1.2 Laminated Aluminum Cover



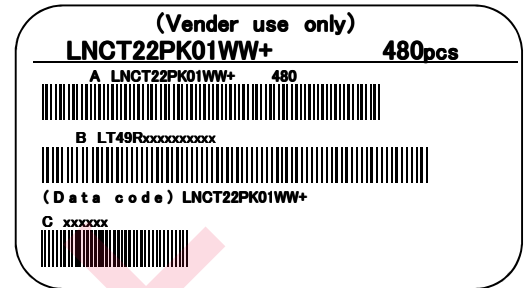
##### 1.3 Packing Case

Material: Card Board Box

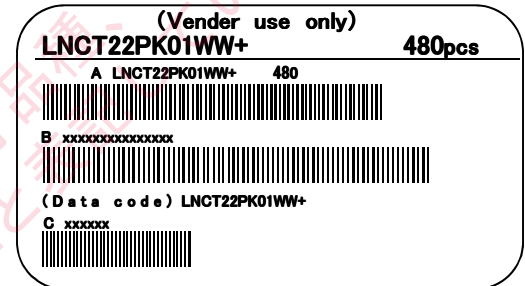
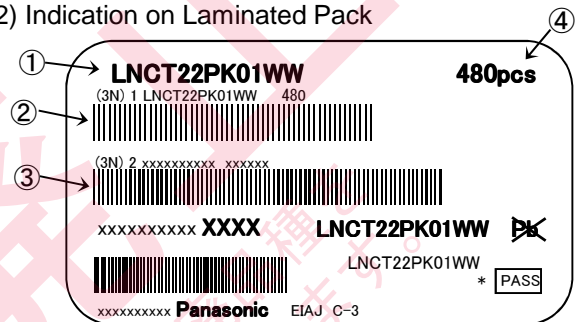


※As for label indication except ① (Order person part number), ② (Order person part number and Quantity), ③ (Serial number and Corporate code), ④ (Quantity), the information only for our process control, therefore please note that revision without notice might be done due to improvement etc.

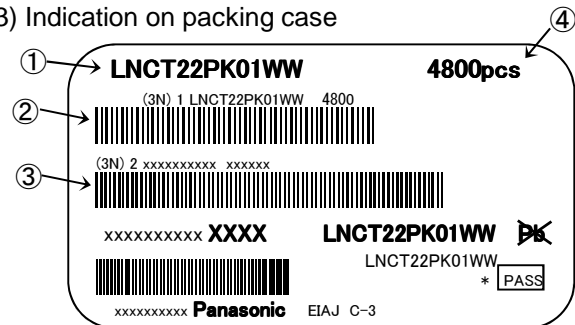
#### 1) Indication on Top Tray



#### 2) Indication on Laminated Pack



#### 3) Indication on packing case



### 2 Packaging Quantity

Form	Quantity	Contents	Note
Tray	n=80	--	--
Laminated Aluminum Cover	n=480	Tray: 7 (Body + Cap)	Wrap The Product and The Desiccant
Packing Case	n=4800	Aluminum Pack 10	--



## Cautions

### ■ Laser class

This product is ranked in class IIIb laser according to IEC60825-1 and JIS standard 6802 "Laser Product Emission Safety Standards", so that safety protection is necessary when laser beam is radiated.

### ■ Flat package laser diode (FLD)

This product is adopting open type plastic package for the reduction of size and weight, so please take care of dust and touching laser diode with tweezers.

### ■ Prevention of Electrostatic discharge (ESD) and surge stress

Semiconductor laser diode is sensitive device to ESD and surge, so that sufficient cautions are needed. If electric pulses that may cause emission are inputted, the laser itself will be damaged by light intensity and will bring the laser diode degradation in a short time. Therefore, taking all possible measures against ESD and surge for FLD usage is strongly requested.

### ■ Heat sink design

If case temperature becomes higher, the life of semiconductor laser diode becomes shorter. So it is important that design for heat radiation is appropriated. Especially it is effective to make the heat radiation from metal moiety of the package back side, locating under the submount and laser diode.

### ■ Precaution at soldering

When soldering, please give attention to the mechanical stress and the temperature because of using Ag paste. Temperature of die-pad portion should be less than 200°C. It is recommended to radiate heat by putting heat sink on the package.

• Soldering temperature and time

• Temperature : Less than 360°C (FLD only)  
Less than 380°C (FLD with holder for heat radiation)

• Time : Within 5sec (Recommend within 3sec)

# ⚠ 安全上のご注意

## ⚠ 危険

レーザービームを見たり触れたりしないでください。  
最悪の場合は、失明または皮膚の損傷の恐れもありますのでご注意ください。

### 本書に記載の技術情報および半導体のご使用にあたってのお願いと注意事項

- (1) 本書に記載の製品および技術情報を輸出または非居住者に提供する場合は、当該国における法令、特に安全保障輸出管理に関する法令を遵守してください。
- (2) 本書に記載の技術情報は、製品の代表特性および応用回路例などを示したものであり、それをもってパナソニック株式会社、ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社または他社の知的財産権もしくはその他の権利の許諾を意味するものではありません。したがって、上記技術情報のご使用に起因して第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責任を負うものではありません。
- (3) 本書に記載の製品は、一般用途(事務機器、通信機器、計測機器、家電製品など)、もしくは、本書に個別に記載されている用途に使用されることを意図しております。  
特別な品質、信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途 — 特定用途(車載機器、航空・宇宙用、輸送機器、交通信号機器、燃焼機器、医療機器、安全装置など)でのご使用を想定される場合は事前に当社営業窓口までご相談の上、使用条件等に関して別途、文書での取り交わしをお願いします。文書での取り交わしなく使用されたことにより発生した損害などについては、当社は一切の責任を負いません。
- (4) 本書に記載の製品および製品仕様は、改良などのために予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。したがって、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、事前に最新の製品規格書または仕様書をお求め願ひ、ご確認ください。
- (5) 設計に際しては、絶対最大定格、動作保証条件(動作電源電圧、動作環境等)の範囲内でご使用いただきますようお願いいたします。特に絶対最大定格に対しては、電源投入および遮断時、各種モード切替時などの過渡状態においても、超えることのないように十分なご検討をお願いいたします。保証値を超えてご使用された場合、その後に発生した機器の故障、欠陥については当社として責任を負いません。  
また、保証値内のご使用であっても、半導体製品について通常予測される故障発生率、故障モードをご考慮の上、当社製品の動作が原因でご使用機器が人身事故、火災事故、社会的な損害などを生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などのシステム上の対策を講じていただきますようお願いいたします。
- (6) 製品取扱い時、実装時およびお客様の工程内における外的要因(ESD、EOS、熱的ストレス、機械的ストレス)による故障や特性変動を防止するために、使用上の注意事項の記載内容を守ってご使用ください。分解後や実装基板から取外し後に再実装された製品に対する品質保証は致しません。  
また、防湿包装を必要とする製品は、保存期間、開封後の放置時間など、個々の仕様書取り交わしの折に取り決めた条件を守ってご使用ください。
- (7) 本書に記載の製品を他社へ許可なく転売され、万が一転売先から何らかの請求を受けた場合、お客様においてその対応をご負担いただきますことをご了承ください。
- (8) 本書の一部または全部を当社の文書による承諾なしに、転載または複製することを堅くお断りいたします。